



新闻中心

热点新闻

行业动态

产业观察

人才资讯

当前位置 > 新闻中心 > 行业动态

宁波江丰同芯半导体材料有限公司举行开业暨投产仪式

来源：大半导体产业网

2月18日，江丰电子控股子公司江丰同芯举行开业暨投产仪式，积极布局第三代半导体相关产业。

据宁波江丰电子材料股份有限公司官微消息，2月18日，江丰电子控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司（以下简称“江丰同芯”）举行开业暨投产仪式。

仪式上，江丰同芯总经理张辉然介绍了公司项目情况。江丰同芯专业从事功率半导体用覆铜陶瓷基板产品的研发、生产、销售及相关产学研项目的合作，产品主要服务于功率半导体模块化产业，广泛应用于5G通信、新能源、轨道交通、特高压、绿色电力等领域。江丰同芯拥有覆铜陶瓷基板行业深耕多年的技术专家数人，目前已搭建完成国内首条具备世界先进水平、自主化设计的第三代半导体功率器件模组核心材料制造生产线。公司规划成为该领域拥有独立知识产权、工艺技术先进、材料规格齐全、产线自动化的国产化覆铜陶瓷基板大型生产基地。

江丰电子董事长兼首席技术官姚力军博士表示，江丰同芯将响应国家号召，积极布局第三代半导体相关产业，不断扩大产能，满足客户和产业链的需求。未来致力于成为覆铜陶瓷基板领域的国产化核心力量，积极推动和协助前端供应链相关材料和装备实现国产化历程。